

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-008



上海新阳半导体材料股份有限公司

2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 309729758 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	张培培	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
传真	021-57850620	021-57850620	
电话	021-57850066	021-57850066	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司业务及产品

公司始终坚持自主研发，持续进行技术创新，经过二十多年发展，主要形成两大类业务，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务，并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。主要产品包括：

（1）晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品

晶圆制造及先进封装用电镀液和添加剂系列产品为公司面向芯片制造领域开发的第二代电子电镀产品。主要包括大马士革铜互连、TSV、Bumping 电镀液及配套添加剂。

（2）晶圆制造用清洗液、蚀刻液系列产品

晶圆制造用蚀刻后清洗液、研磨后清洗液以及蚀刻液系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子清洗液系列产品。主要包括铜制程蚀刻后清洗液、铝制程蚀刻后清洗液、氮化硅/钛蚀刻液、化学机械研磨后清洗液等。

（3）集成电路制造用高端光刻胶产品系列

集成电路制造用高端光刻胶系列产品为公司面向芯片制造领域开发的电子光刻系列产品。包括 I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 干法、浸没式光刻胶以及稀释剂、底部抗反射膜（BARC）等配套材料，主要用于逻辑、模拟和存储芯片生产制造。

（4）晶圆制造用化学机械研磨液

公司化学机械研磨液主要包括适用于浅槽隔离研磨液（STI Slurry）、金属钨研磨液(W Slurry)、金属铜研磨液(Cu Slurry)、硅氧化层研磨液(Oxide Slurry)，多晶硅层研磨液(Poly Slurry)等系列产品，研磨液产品可覆盖 14nm 及以上技术节点。

（5）半导体封装用电子化学材料

半导体封装用电子化学材料为用于半导体引线脚表面镀锡的化学材料及其配套电镀前处理、后处理化学材料，是公司面向传统封装领域开发的第一代电子电镀与电子清洗产品，包括无铅纯锡电镀液及添加剂、去毛刺溶液等。

（6）配套设备产品

配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。

（7）氟碳涂料产品系列

环保、功能性氟碳涂料包括：PVDF 氟碳粉末涂料、氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、超细耐候粉末涂料等。

（8）其它产品与服务

其它产品与服务主要为围绕半导体产业和泛半导体产业开展的相关业务，主要在子公司进行。包括：晶圆湿法工艺技术开发与服务、晶圆划片刀、平板显示用光刻材料、集成电路制造用抛光液磨料的研发等。

（三）主要经营模式

1、研发模式

公司围绕自身的核心技术，面向集成电路产业当前和未来需求，以自主研发、自主创新为主，开展集成电路制造用关键工艺材料的研发和产业化。始终坚持以技术主导为核心，持续研发创新，积极融入国家创新体系。通过自主评估并结合国家科技重大专项的需求设立研发项目，开展产品开发、应用技术开发和生产工艺开发。同时与客户保持密切合作，针对性研发满足客户需求的产品，为其开发创新性的解决方案。通过对产品性能的不断优化及应用和生产工艺的提升，持续满足客户的需求。

2、采购模式

公司根据 ISO 质量体系要求，制定了《采购控制程序》，《采购流程》《供应商管理流程》做到规范化，系统化的执行各项采购工作。

a.一般材料需求部门根据计划或者实际情况提交采购申请，实行采买；

b.原材料采购，由需求部门提出材料需求，由质量部，技术中心共同评估材料的指标性能，招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应；

c.固定资产和工程类采购，由相关部门参与评审，招标后按合同约定开展。

3、生产模式

公司采用以销定产的方式确定生产量。计划部每月月初根据市场部统计的订单情况以及备货策略，编制当月的生产计划，生产部合理安排实施当月生产。每周生产部和计划部

还会依据市场订单的变化及生产进度调整生产计划，以满足客户的产品需求的同时提高产品周转率。

4、销售模式

公司采用的是直销模式。公司在半导体材料领域深耕二十多年，积累了良好的客户资源，并和其中的一些客户形成了战略合作关系。公司市场部负责跟进、整理公司所属行业发展情况，制定公司市场战略规划，制定公司业务目标以及产品市场的开发和产品销售工作。公司市场人员直接与客户进行商务洽谈，达成初步交易意向，签订销售合同。市场部销售人员负责与客户进行订单确认、评审、发货计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司持续为客户提供优质产品和服务的同时，通过挖掘已有客户新需求和不断开发新客户保证公司营业收入的持续增长。

5、服务模式

公司在集成电路制造用关键工艺材料及设备领域深耕细作，在为客户提供优质产品的同时，更能为客户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案，快速响应客户需求，多方位整合公司资源，创新研发，为客户带来丰富和优质的服务方案，提升客户的产品竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,588,589,806.19	5,620,352,673.68	-0.57%	6,652,746,039.73
归属于上市公司股东的净资产	4,188,533,225.02	4,113,567,347.16	1.82%	4,984,546,810.56
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,212,420,426.53	1,195,686,064.34	1.40%	1,016,367,386.05
归属于上市公司股东	166,840,625.59	53,234,183.54	213.41%	93,668,329.40

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,070,944.40	111,611,267.84	10.27%	84,718,380.69
经营活动产生的现金流量净额	151,385,721.60	-38,609,613.85	492.09%	175,828,684.82
基本每股收益（元/股）	0.5389	0.1707	215.70%	0.3044
稀释每股收益（元/股）	0.5389	0.1707	215.70%	0.3044
加权平均净资产收益率	3.74%	1.21%	2.53%	2.47%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	260,864,353.08	290,887,831.51	318,754,516.93	341,913,725.01
归属于上市公司股东的净利润	56,396,751.69	30,408,572.18	27,028,519.01	53,006,782.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,866,936.01	29,085,396.44	18,288,262.79	51,830,349.16
经营活动产生的现金流量净额	-5,896,658.28	-9,696,686.26	58,753,968.29	108,225,097.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,307	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,685	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052.00	不适用				0.00
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	11.39%	35,698,176.00	0.00	质押				3,130,000.00
上海新科投资	境内非国有法人	7.27%	22,788,086.00	0.00	质押				2,000,000.00

有限公司	人					
SINYANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	3.46%	10,832,590.00	0.00	不适用	0.00
孙慧明	境内自然人	3.18%	9,969,938.00	0.00	不适用	0.00
金叶飞	境内自然人	1.60%	5,005,223.00	0.00	不适用	0.00
杨燕灵	境内自然人	1.29%	4,043,700.00	0.00	不适用	0.00
金叶玲	境内自然人	0.96%	2,994,390.00	0.00	不适用	0.00
张滕	境内自然人	0.76%	2,382,084.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	2,232,805.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海新晖资产管理有限公司	37,397,976	11.93%	535,300	0.17%	35,698,176	11.39%	2,235,100	0.71%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杨燕灵	新增	0	0.00%	4,043,700	1.29%
江苏新潮科技集团深圳企业管理咨询有限公司	退出	0	0.00%	501,300	0.16%
陈晓钧	退出	0	0.00%	248,300	0.08%

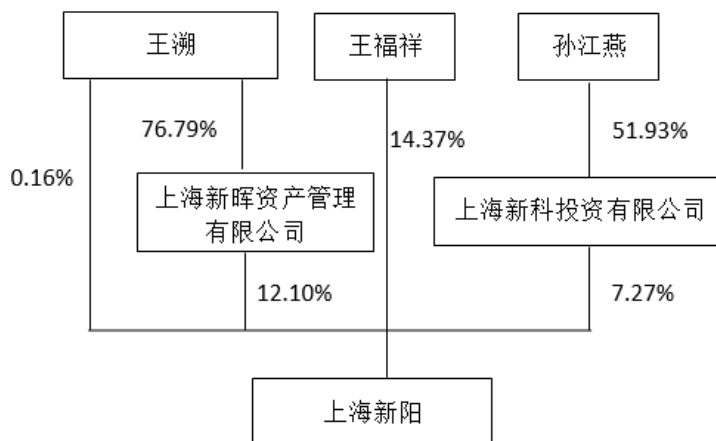
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2023 年全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，宏观经济逐步复苏，虽不及预期，但整体市场仍然充满活力。新挑战、新机遇、新技术、新应用并存。公司管理层围绕长期发展战略和年度经营目标，积极作为、用心管理，群策群力，紧跟市场需求变化，凭借敏锐的市场洞察力、出色的产品创新力以及果敢的经营执行力，进一步提升产品核心竞争优势与市场占有率。

报告期内，公司实现营业收入 12.12 亿元，较去年同期略有增长。实现归属于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增长 213.41%，扣除非经常性损益后净利润为 1.23 亿元，同比增长 10.27%。公司半导体行业实现营业收入 7.68 亿元，同比增长 20.06%，主要是公司半导体业务板块产品类型不断丰富，市场开发力度不断加强，取得客户订单数量持续增加。尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加

剂系列产品市场份额快速增长，集成电路制造用清洗系列产品在客户端认证顺利，销售增长迅速。涂料板块业务，受建筑行业市场环境低迷、涂料产品售价大幅下降等不利因素影响，2023 年实现营业收入 4.44 亿元，较去年同期下降 20.08%。

1、公司技术创新优势不断凸显

公司坚定不移地贯彻执行以技术为主导，始终坚持自主研发，持续创新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空白，面向进口替代的战略定位。报告期内，面对产业快速发展及下游客户的迭代需求，公司围绕四大核心业务技术，持续研发投入，创新产品，为客户提供整体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 1.48 亿元，占本期营业收入的比重为 12.27%，主要集中于集成电路制造用光刻胶、先进制程湿法刻蚀液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等项目。

在集成电路制造及先进封装材料领域，随着芯片技术的向前发展，推动芯片朝着高性能（大功率、高算力）和轻薄化（体积/面积小）两个方向提升，芯片铜互连成为主流互连工艺技术。电镀系列产品——大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、凸点工艺（Bumping）广泛应用，来实现金属之间的互联。公司电镀液及其添加剂是实现互联技术的关键工艺材料。经过多年的开发、技术储备以及与客户紧密的联系，报告期内公司电镀液添加剂相关产品销售规模快速提升，与去年同期相比增长达 50%。

在集成电路制造用清洗液产品方面，28nm 干法蚀刻后清洗液产品已规模化量产，14nm 技术节点干法蚀刻后清洗液也已量产并实现销售，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。本报告期干法蚀刻后清洗液产品销售规模不断扩大，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造客户。其中，铝互连干法蚀刻后清洗液长期受制于国外唯一原材料供应商限制，面对先进制程所需的配套材料亦需国产化的现状，公司自主研发攻关的防“卡脖子”的关键原材料项目——非羟胺清洗液项目，已开发出满

足晶圆制造企业要求的无羟胺干法蚀刻后清洗液产品，并在国内主流晶圆制造客户端通过验证并实现销售，报告期内该项目产品的清洗能力不断提升。公司报告期内开发的钨残留去除液一次性通过客户测试验证，并取得订单，新产品的开发销售将不断拓展公司清洗液产品应用市场。在公司原创开发的蚀刻液产品方面，持续纵深开发，做好前瞻性研究和技術储备，针对 14nm 及以下、3D 存储工艺需求的刻蚀/清洗类配方型化学品技术积极布局重点开发，进一步扩大市场应用，引领行业发展。公司清洗类产品的技术及服务优势不断凸显，品牌影响力不断提高，产品渗透率持续提升。

在光刻胶及研磨液两大类产品方面，报告期内均取得了长足的进展与突破。其中，光刻胶项目研发进展顺利，I 线、KrF 光刻胶产品工艺性能指标不断优化提升，满足客户的工艺需求。目前光刻胶已具备量产能力，在超 20 家客户端提供样品进行测试验证，报告期内光刻胶产品销量快速增加。ArF 光刻胶的研发进展也比较顺利，浸没式光刻胶目前已有多款产品在国内多家晶圆制造企业开展测试验证工作，部分型号产品已取得良好的测试结果及工艺窗口，技术指标与对标产品比较接近。报告期内光刻胶系列产品已实现营业收入 400 余万元。在研磨液系列产品方面，基础研发、生产工艺、分析开发等方面工作进展迅速，已形成成熟的 STI Slurry、Poly slurry，W slurry 系列产品在超过 20 余家客户端测试验证，其中 W slurry 系列产品在客户端验证顺利，有望率先量产应用。本报告期公司化学机械研磨液已有多款产品通过客户测试，实现销售。

公司多年来始终如一，坚持自主创新，充分挖掘自身潜力，与产业链上下游协同创新发展，坚定不移地围绕国家被“卡脖子”关键工艺材料产品，围绕公司核心技术持续创新，不断突破，不断提升公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力。

2、半导体业务规模持续扩大

半导体行业的发展对科技和经济发展具有重要意义。随着整个半导体产业的持续增长以及中国大陆不断新建代工产能的增加，中国大陆半导体市场规模增速将会持续超越全球

增速，成为全球最大的半导体材料市场。公司开发的集成电路制造用关键工艺材料产品仍然面临旺盛的市场需求。公司布局规划的电镀液及添加剂、清洗液、刻蚀液、光刻胶、研磨液等化学品材料产能不断加强完善，其中上海松江厂区年产能 1.9 万吨扩充目标已建设完成，合肥第二生产基地一期 1.7 万吨已基本具备投产条件，建设有原料储罐及自动加料系统、自动称量系统、自动控制系统等自动化和智能化设备设施。合肥二期规划 5.3 万吨年产能各类手续正在办理中。本报告期，公司化学品产出近 1.4 万吨，其中晶圆制造用化学材料产品产量占比超 70%。为了进一步巩固在国内半导体材料行业的领先地位，根据市场需求及规模情况，公司与上海化学工业区管理委员会、上海化学工业区发展有限公司签订《投资意向协议》，启动位于上海化学工业区的项目建设，规划占地 104 亩，建筑面积 6.5 万平方米，合计产能 6 万吨，该项目主要用于开发光刻胶及配套材料产业化建设。随着公司在半导体业务产能方面布局的持续完善，新基地的陆续建成投产，公司产能规模不断释放，对市场的供应能力逐步增强，能够满足未来市场需求的增长。

3、深化半导体气息

新阶段的新阳公司，始终围绕技术引领、产品引领、市场引领的战略目标，持续创新、创造，打造自身的技术创新优势和未来增长动力，重视体系建设、技术升级及前瞻性研究，努力成为半导体材料行业引领者。

2023 年全年公司围绕“持续推进半导体气息”管理主题，一方面从企业运营着手，不断实践，不断优化完善管理体系，重点关注市场规划、供应链管理、质量管理、技术创新、安全生产等方面工作，全力落实推进基础数据上线，数据互通、业财融合的系统改造升级任务，实现信息交互同步，优化交叉业务流程，以便满足未来集团战略管控需要，支持集团发展目标。

另一方面公司注重人才团队的培养建设和员工生活。随着公司业务规模的不断扩大，员工人数持续增加。截止报告期末，公司半导体业务板块人员净增 112 人，同比增长 22%。

面对快速发展的行业现状及人员增加，公司也同样注重人才的能力和团队的建设，公司结合行业现状及公司发展规划，完善各层级人才梯队建设，开展行业动态讲座，强化师徒带教的人才培养模式，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，让员工与公司共同成长，持续进步。

在员工生活方面，公司通过持续开展“心温暖”民主对话会活动倾听员工心声，开展半导体气息知识有奖问答活动，持续提升全员半导体气息意识，组织聚力凝心三峡团建活动、健身运动等等活动，关注员工生活、倾听员工心声、激发员工工作和生活热情，提高员工企业文化认同感。

报告期内，公司完成了 2022 年度股份回购计划，回购公司股份 2,632,685 股，用于公司股权激励计划。2023 年公司持续实施股权激励及员工持股的一揽子计划，践行薪酬证券化长效激励机制，实施了新成长（二期）股权激励计划及芯征途（二期）员工持股计划，持续与员工共享公司发展红利，提升员工在企幸福指数。未来公司还会持续推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引、聚集优秀人才，为公司未来长期稳定的可持续发展提供强有力的人才保障。

通过各项“深化半导体气息”工作的不断开展，目标是增强公司的生存成长能力和行业影响力，提升每一位员工的个人品格魅力和职业素养，最终实现企业竞争力的全面提升。

4、参与产业投资，助力产业发展

长期以来公司持续加深在集成电路关键工艺材料领域的投资布局，投资推动半导体专用设备产品及核心原材料企业的发展。另一方面，公司亦积极参与产业投资，除前期投资的苏州安芯同盈创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏新潮万芯创业投资合伙企业（有限合伙）等项目外，报告期内还投资了长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）项

目，在完善公司半导体产业链布局的同时，助力半导体材料装备发展，与公司主营业务产生协同作用，不断拓展和加强公司产业实力及行业影响力。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2024 年 3 月 13 日